

集成电路及电子元器件检测第三方检测机构

产品名称	集成电路及电子元器件检测第三方检测机构
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18002557368

产品详情

物（化）性失效分析 PFA

Decap 开封

Bare Die Extraction 取晶粒

De-layer/De-process 去层解剖

Staining-Rom Code 码点染色

Staining-P/N 阱染色

Staining-Resistor zone电阻染色

De-Gold Bump去金凸块

金相分析

精密定点及非定点研磨制样/金相切片

显微观察分析（Lieca DM8000紫外干涉150X、Hitachi S4800冷场发射电镜+EDS）

电性失效分析EFA

EMMI微光显微检查

LCHot Spot 液晶热点侦测

OBIRCH 镭射光束诱发阻值变化测试

Probe Station探针应用

FIB聚焦离子束应用

微线路修改

测试键生成

Cross-Section

精密切割及加工

无损侦测

X-Ray+3DCT (三维断层扫描技术) C-SAM 扫描超声波芯片逆向工程及工艺评估

成功的正向设计需要随时更新已有设计思路，纠正设计缺陷。反向设计作为一种辅助工具，可以帮助电路设计工程师在短时间里积累足够多的设计经验并开发适合自身设计水平的工艺参数，有效规避风险、提高效率。也可帮助设计公司提升产品竞争力，或为保护自主产品知识产权提供有效证据。

静电放电/门锁效应测试ESD-HBM人体模式

ESD-MM机器放电模式

ESD-CDM充电元器件模式Latch-Up门锁效应测试

材料分析

AES俄歇电子能谱仪应用

AFM原子力显微镜应用

EELS电子能量损失分析仪应用FT-IR傅立叶红外显微镜应用

SEM/EDS扫描电子显微镜/X射线能谱仪应用

SIMS二次离子能谱仪 (特殊定点/非定点制样、元素分析)

TEM 透射电镜 (定点/非定点制样及上机观察)

TOF-SIMS 飞行时间二次离子质谱应用

XPSX射线光电子能谱仪应用

可靠性测试

静态环境可靠性测试..

动态环境可靠性试验....

机械应力可靠性试验...

高加速寿命试验...